

P 型非晶氧化物半導體原子層沈積系統

注意事項

1. 本機台不對外開放，僅進駐單位學研團隊成員及 TSRI 指定之同仁，通過考核並登記成使用者後，始可使用。
2. 設備使用前，請務必檢查機台狀況、溫度、壓力是否正常。
3. 使用設備需確實填寫使用紀錄簿。
4. 本設備提供 6 吋、8 吋及破片矽晶片進入，如有特殊情況，須先與設備工程師討論。
5. 請勿隨意調整製程溫度，如有特殊情況，須先與設備工程師討論。
6. 單次薄膜沉積厚度不得超過 20 奈米。
7. 每張申請單，最多可申請 3 片晶圓進行委託。

實驗室機台設備安全宣告

1. 操作期間無論發生有感地震、停電、毒氣或火災警報的狀況時，所有的人必須立即循逃生方向撤離實驗室。
2. 遇有氣體外洩、火災燃燒或人員傷害等緊急狀況時，請通知**緊急應變指揮中心協助處理(分機 7761& 7762)**。
3. 確認使用該機台可能需要防護具的使用方法及其所在位置，例如：緊急沖淋器、空氣呼吸器、滅火器、藥膏等。
4. 此系統只允許使用矽基板的核可使用者才能操作。
5. 實驗條件之設定狀況不得超過原有之設定範圍(如氣體流量，製程溫度以及製程壓力...等)。
6. 請注意工程師公告機台設備相關之停用製程或服務功能。如有發現其他同學不按照規定使用機台設備(未登記使用紀錄、未依 SOP 操作，使用不被允許或其他可能造成機台損壞的物料)，請儘速告知工程師 (**7510**) 處理或工安人員(分機 **7737**)。
7. 機台設備如果有不能正常工作的狀況時，請先查閱之前紀錄且將發生狀況說明於紀錄簿上，並於工程師的電話中留言，工程師會儘速診斷原因並予以回應。
8. 在你離開前，請注意再確認機台所有的組件及模組，製程氣體流量和溫度是否設定回待機模式。並且，詳實填寫實驗紀錄簿。
9. 任何人若不遵守以上指示將會依**本中心管理規則**懲處。